

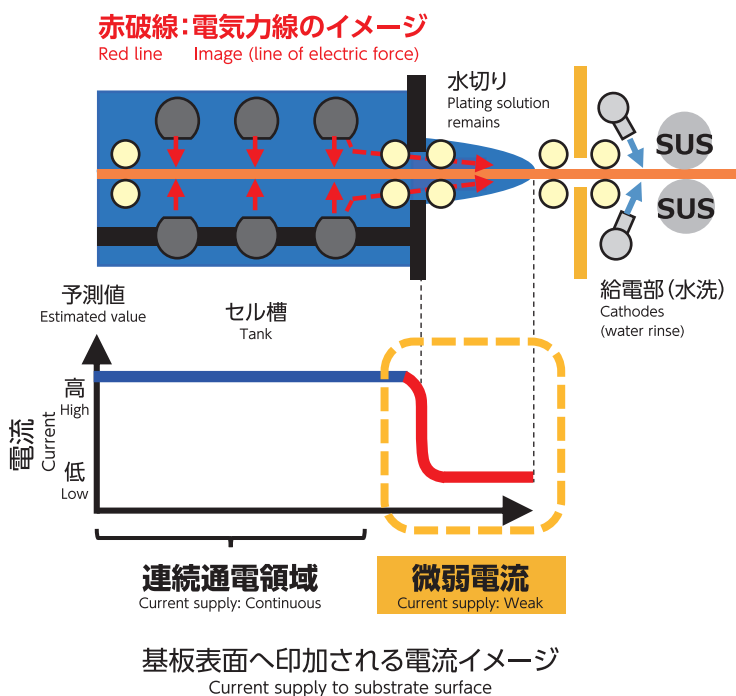
トッパールチナSVP

TOP LUCINA SVP

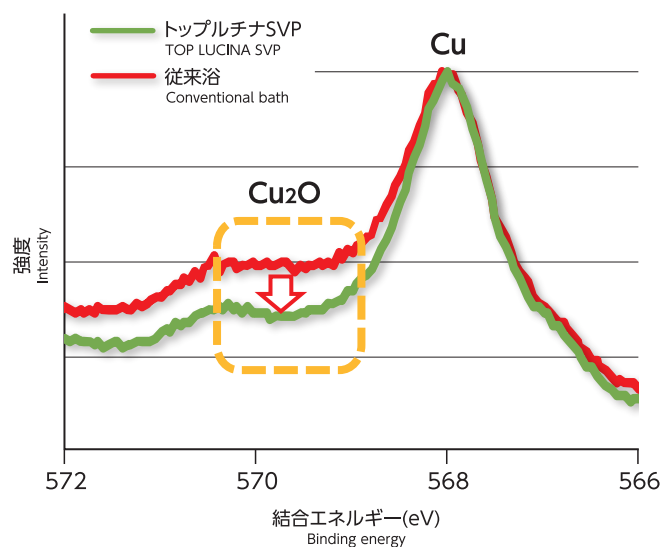
- Roll to Roll装置を用いためっきにおける課題の微弱電流印加による影響を改善し、ビアフィリング性能を大きく向上
Reduce the impact by weak current between conveyer transport, improve via-filling performance
- 定量分析が可能
Quantitative analysis is possible for all additives

セル槽間の微弱電流の印加による銅酸化物の形成を抑制

Prevent forming copper oxides caused by weak current application between tank



微弱電流印加時の化学結合状態
Chemical bonding state under weak current supply



酸化銅(I)の形成を抑制
Prevent copper (I) oxide formation

Roll to Roll装置におけるビアフィリング性能の向上

Improve via-filling performance in Roll to Roll equipment

	トッパールチナSVP TOP LUCINA SVP	従来浴 Conventional bath
フィリング性 Via-filling performance ビア径 75 μm Hole diameter ビア深さ 36 μm Hole depth		
スローイングパワー Throwing power 穴径 100 μm Hole diameter		
めっき条件(6 A/dm ² , 30 s)⇔(0.2 A/dm ² , 5 s) Plating condition	表層膜厚 12 μm Surface thickness	

良好なフィリング性とスローイングパワーを両立
Realize high via-filling performance and throwing power together